

Dell EMC PowerEdge R6525

技术规格

注意、小心和警告

 **注：**“注”表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

 **小心：**“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。

 **警告：**“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

章 1: 技术规格	4
机箱尺寸.....	5
系统重量.....	6
处理器规格.....	6
PSU 规格.....	6
支持的操作系统.....	6
冷却风扇规格.....	7
系统电池规格.....	11
扩展卡提升板规格.....	11
内存规格.....	12
存储控制器规格.....	12
驱动器规格.....	13
驱动器.....	13
端口和连接器规格.....	13
USB 端口规格.....	13
NIC 端口规格.....	13
串行连接器规格.....	14
VGA 端口规格.....	14
IDSDM.....	14
视频规格.....	14
环境规格.....	15
散热空气限制.....	16
散热限制值表.....	17

技术规格

本节概述了系统的技术规格和环境规格。

主题：

- 机箱尺寸
- 系统重量
- 处理器规格
- PSU 规格
- 支持的操作系统
- 冷却风扇规格
- 系统电池规格
- 扩展卡提升板规格
- 内存规格
- 存储控制器规格
- 驱动器规格
- 端口和连接器规格
- 视频规格
- 环境规格

机箱尺寸

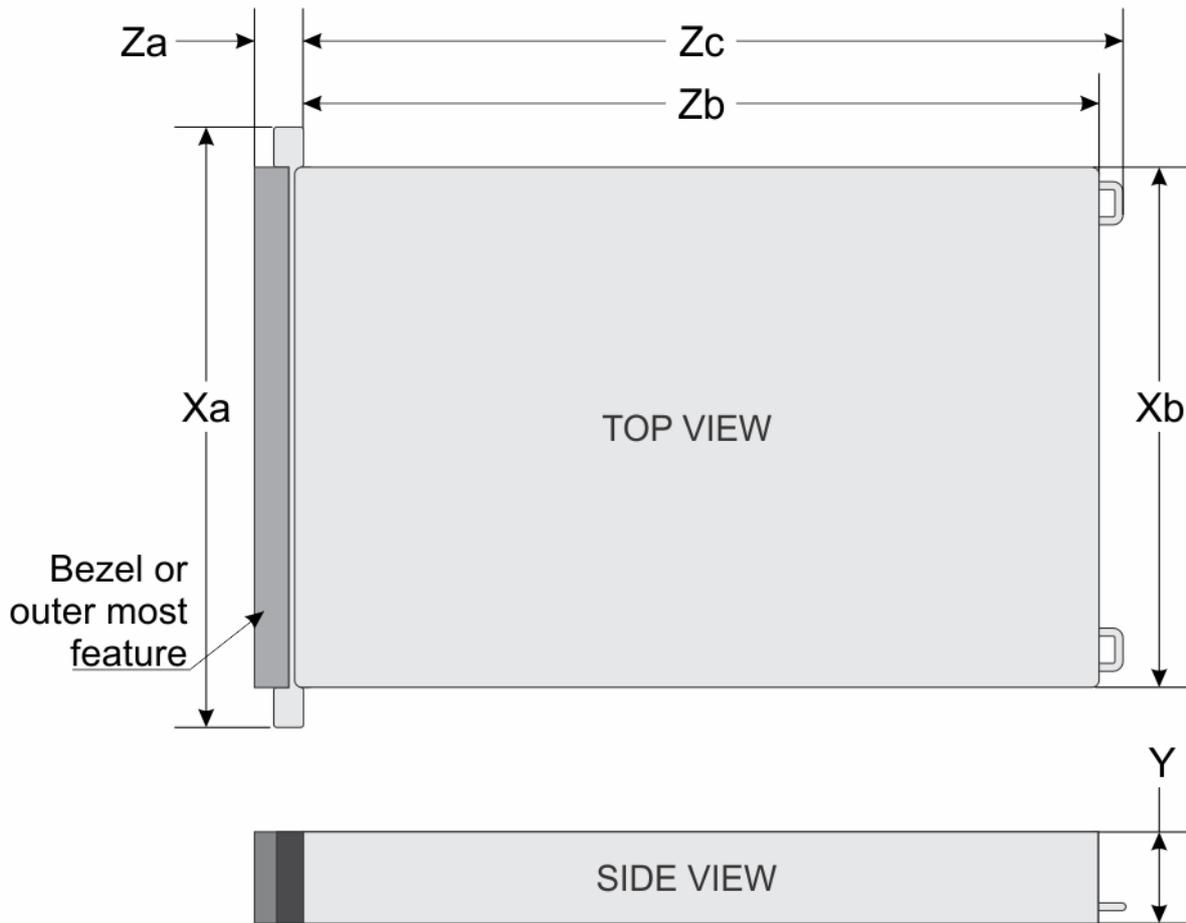


图 1: 机箱尺寸

表. 1: PowerEdge R6525 机箱尺寸

驱动器	Xa	Xb	Y	Za	Zb*	Zc
八个驱动器	482.0 毫米 (18.97 英寸)	434.0 毫米 (17.08 英寸)	42.8 毫米 (1.68 英寸)	带挡板: 35.84 毫米 (1.4 英寸) 不带挡板: 22.0 毫米 (0.87 英寸)	700.53 毫米 (27.58 英寸) (双耳到后壁)	736.27 毫米 (28.98 英寸) (双耳到 PSU 手柄)
四个或十个驱动器	482.0 毫米 (18.97 英寸)	434.0 毫米 (17.08 英寸)	42.8 毫米 (1.68 英寸)	带挡板: 35.84 毫米 (1.4 英寸) 不带挡板: 22.0 毫米 (0.87 英寸)	751.48 毫米 (29.58 英寸) (双耳到 I/O 标签)	787.05 毫米 (30.98 英寸) (双耳到 PSU 手柄)

注: Zb* 是进入系统主板 I/O 连接器所在的标称后墙外表面。

系统重量

表. 2: PowerEdge R6525 系统重量

系统配置	最大重量 (包括所有驱动器/SSD)
4 x 3.5 英寸	21.8 千克 (48.06 磅)
8 x 2.5 英寸	19.2 千克 (42.33 磅)
10 x 2.5 英寸	21.8 千克 (48.06 磅)

处理器规格

表. 3: PowerEdge R6525 处理器规格

支持的处理器	支持的处理器数量
AMD EPYC 7002 或 7003 系列处理器	两个

PSU 规格

PowerEdge R6525 系统支持多达两个交流或直流电源装置 (PSU)。

警告: 仅供合格电工参阅的说明:

使用 $-(-48-60)$ V DC 或 240 V DC 电源装置的系统专用于限定的访问位置, 符合美国国家电气规范、美国国家标准学会 (ANSI)/美国国家消防协会 (NFPA) 70 的第 110-5、110-6、110-11、110-14 和 110-17 款。

240 V DC 电源装置应连接到来自认证配电装置的 240 V DC 电源插座 (如果在所使用的国家/地区适用)。

电源线/跳线及关联的插头/进线/连接器在用于连接时, 应具有相应的电气额定值, 以参考系统上的额定值标签。

表. 4: PowerEdge R6525 PSU 规格

PSU	类别 (仅限交流)	散热 (最大)	频率	电压	当前
800 W 混合模式	白金级	3000 BTU/小时	50/60 Hz	100 - 240 V 交流	9.2 - 4.7 A
	不适用		直流	240 V 直流	3.8 A
1100 W 混合模式	钛金级	4100 BTU /小时	50/60 Hz	100-240 V AC	12 A-6.3 A (X2)
	不适用		直流	240 V 直流	5.2 A DC
1100 W (-48 V DC)	不适用	4265 BTU/小时	直流	$(-48)-(-60)$ V DC	27 A
1400 W 混合模式	白金级	5250 BTU/小时	50/60 Hz	100 - 240 V AC	12 - 8 A AC
	不适用		直流	240 V 直流	6.6 A DC

注: 选择或升级系统配置时, 为了确保最佳电源利用率, 请使用 Dell.com/ESSA 上的戴尔能源智能解决方案顾问验证系统功耗。

支持的操作系统

PowerEdge R6525 支持以下操作系统:

- Canonical Ubuntu Server LTS
- Citrix XenServer
- 带 Hyper-V 的 Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server

- VMware vSAN/ESXi
有关更多信息，请访问 www.dell.com/ossupport。

冷却风扇规格

PowerEdge R6525 系统支持多达四个标准 (STD)、高性能银牌级 (HPR, 银牌) 或极高性能金牌级 (HPR, 金牌) 双冷却风扇模块。

表. 5: 冷却风扇规格

风扇类型	简写	也称为	标签颜色	标签图像
标准风扇	STD	STD	无标签	 <p>图 2: 标准风扇</p>
高性能 (银牌级) 风扇	HPR (银牌)	HPR	银牌级	<p>注: 新的冷却风扇附带高性能银牌级标签。当较旧的冷却风扇具有高性能标签时。</p>

表. 5: 冷却风扇规格 (续)

风扇类型	简写	也称为	标签颜色	标签图像
				 <p data-bbox="770 1272 951 1301">图 3: 高性能风扇</p>

表. 5: 冷却风扇规格 (续)

风扇类型	简写	也称为	标签颜色	标签图像
				 <p data-bbox="772 1272 1070 1301">图 4: 高性能 (银牌级) 风扇</p>
高性能 (金牌级) 风扇	HPR (金牌)	VHP 一极高性能	金牌级	<p data-bbox="772 1361 1481 1417">注: 新冷却风扇附带高性能金牌级标签。当较旧的冷却风扇具有高性能标签时。</p>

表. 5: 冷却风扇规格 (续)

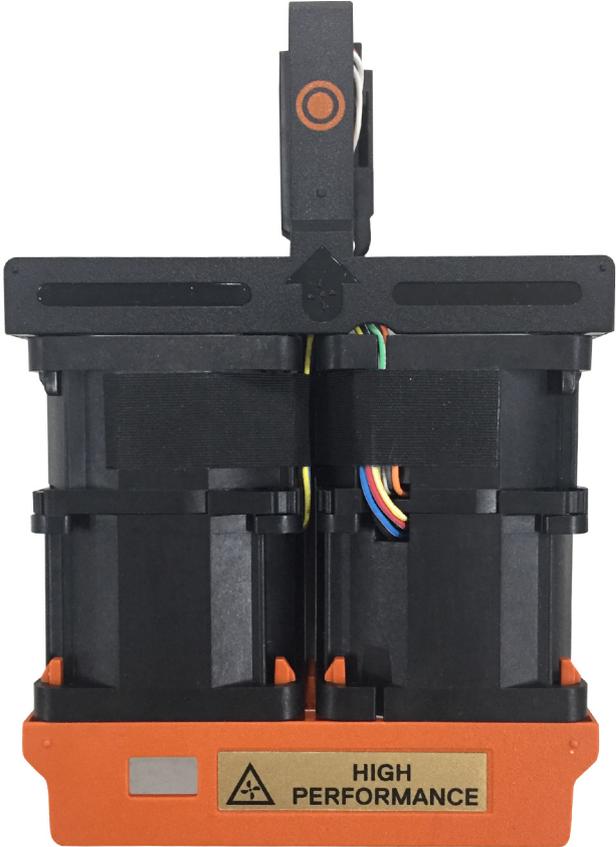
风扇类型	简写	也称为	标签颜色	标签图像
				 <p data-bbox="770 1272 951 1301">图 5: 高性能风扇</p>

表. 5: 冷却风扇规格 (续)

风扇类型	简写	也称为	标签颜色	标签图像
				

图 6: 高性能 (金牌级) 风扇

- 注: 您可以通过标签颜色来区分高性能 (银牌) 风扇和极高性能 (金牌) 风扇。
- 注: 不支持混合使用 STD、HPR (银牌) 或 VHP (金牌) 风扇。
- 注: STD、HPR (银牌) 或 VHP (金牌) 风扇的安装取决于系统配置。有关支持的风扇配置或值表的详细信息, 请参阅[散热限制值表](#)。

系统电池规格

PowerEdge R6525 系统支持的系统电池为 CR 2032 3.0-V 纽扣式锂电池。

扩展卡提升板规格

警告: 不应在企业级服务器产品中安装或使用消费者级 GPU。

PowerEdge R6525 系统支持多达四个 PCI express (PCIe) 4.0 扩展卡。

表. 6: 系统板上支持的扩展卡插槽

PCIe 插槽	提升卡	提升板宽度	PCIe 插槽高度	PCIe 插槽长度	插槽宽度
插槽 1	R2a (提升板 2)	x32 PCIe	薄型	半长	x16
插槽 1	R1a (提升板 1)	x16 PCIe	全高	3/4 长	x16
插槽 2	R2a (提升板 2)	x32 PCIe	薄型	半长	x16
插槽 2	R4c + R4d (提升板 4)	x16 PCIe	全高	3/4 长	x16
插槽 3	R3a (提升板 3)	x16 PCIe	薄型	半长	x16

内存规格

PowerEdge R6525 系统支持以下内存规格以优化操作。

表. 7: 内存规格

DIMM 类型	DIMM 列	DIMM 容量	单处理器		双处理器	
			最小 RAM	最大 RAM	最小 RAM	最大 RAM
RDIMM	单列	8 GB	8 GB	128 GB	16 GB	256 GB
	双列	16 GB	16 GB	256 GB	32 GB	512 GB
		32 GB	32 GB	512 GB	64 GB	1 TB
		64 GB	64 GB	1 TB	128 GB	2 TB
LRDIMM	四列	128 GB	128 GB	2 TB	256 GB	4 TB
	八列	128 GB	128 GB	2 TB	256 GB	4 TB

i 注: 具有 x4 数据宽度和 8 Gb DRAM 密度的旧 32 GB 容量 RDIMM 内存不能与同一 AMD EPYC™ 处理器单元中具有 x8 数据宽度和 16 Gb DRAM 密度的较新的 32 GB 容量 RDIMM 内存混合使用。

i 注: 速度为 2666 MT/s 的旧 128 GB 容量 LRDIMM 内存不能与速度为 3200 MT/s 的新 128 GB 容量 LRDIMM 内存混合。

表. 8: 内存模块插槽

内存模块插槽	速度
32, 288 针	3200 MT/s、2933 MT/s、2666 MT/s

存储控制器规格

PowerEdge R6525 系统支持以下控制器卡：

表. 9: PowerEdge R6525 系统控制器卡

内部控制器	外部控制器
<ul style="list-style-type: none"> PERC H755N PERC H745 HBA345 HBA355 S150 H345 启动优化存储子系统 (BOSS-S1): HWRAID 2 x M.2 SSD Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): HWRAID 2 x M.2 SSD 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Gbps SAS 外部 HBA PERC H840 HBA355E

注: PowerEdge R6525 系统的前置 PERC 模块连接到驱动器背板。前置 PERC 模块通过两种不同方式连接:

- 正面安装的前置 PERC 模块
- 背面安装的前置 PERC 模块

驱动器规格

驱动器

PowerEdge R6525 系统支持:

- 4 x 3.5 英寸热插拔 SAS、SATA 驱动器
- 8 x 2.5 英寸热插拔 SAS、SATA 驱动器
- 10 x 2.5 英寸热插拔 SAS、SATA 或 NVMe 驱动器
- 10 + 2 x 2.5 英寸热插拔 SAS、SATA 或 NVMe 驱动器

底板:

- 多达 2 x 2.5 英寸 SAS、SATA 或 NVMe 驱动器
- 多达 4 x 3.5 英寸 SAS、SATA 驱动器
- 多达 8 x 2.5 英寸 SAS、SATA 驱动器
- 多达 10 x 2.5 英寸 SAS、SATA 或 NVMe 驱动器

注: 有关如何热插拔 NVMe PCIe SSD U.2 设备的更多信息, 请参阅《Dell Express Flash NVMe PCIe SSD 用户指南》, 网址: <https://www.dell.com/support> 浏览所有产品 > 数据中心基础架构 > 存储适配器和控制器 > Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCIe SSD > 文档 > 手册和文档。

端口和连接器规格

USB 端口规格

表. 10: PowerEdge R6525 系统 USB 规格

正面		背面		内部	
USB 端口类型	端口数	USB 端口类型	端口数	USB 端口类型	端口数
USB 2.0 兼容端口	一个	USB 3.0 兼容端口	一个	内置 USB 3.0 兼容端口	一个
Micro-USB 2.0 兼容端口	一个	USB 2.0 兼容端口	一个		

注: Micro USB 2.0 兼容端口只可以用作 iDRAC Direct 或管理端口。

注: USB 2.0 规格提供了一个单线 5 V 电源装置, 用于为连接的 USB 设备供电。设备负载在 USB 2.0 中定义为 100 mA, 在 USB 3.0 中定义为 150 mA。设备可能会从 USB 2.0 中的端口最多消耗 5 个设备负载 (500 mA); 从 USB 3.0 消耗 6 个设备负载 (900 mA)。

注: USB 2.0 接口可为低功率外围设备供电, 但必须符合 USB 规格。要运行高级外围设备 (例如外部 CD/DVD 驱动器), 需要外部电源。

NIC 端口规格

PowerEdge R6525 系统支持嵌入在主板 LAN (LOM) 上以及集成在可选的 OCP 卡上的多达两个 10/100/1000 Mbps 网络接口控制器 (NIC) 端口。

表. 11: NIC 端口规格

功能部件	规格
LOM 卡	1 GB x 2
OCP 卡 (OCP 3.0)	1 GbE x 4、10 GbE x 2、25 GbE x 2、25 GbE x 4、50 GbE x 2、100 GbE x 2

串行连接器规格

PowerEdge R6525 系统在背面板上支持一个可选的卡类型串行连接器，该 9 针连接器是一种兼容 16550 的数据终端设备 (DTE)。可选的串行连接器卡安装类似于扩展卡填充挡片支架。

VGA 端口规格

PowerEdge R6525 系统的前面板和后面板上支持一个 DB-15 VGA 端口。

IDSDM

PowerEdge R6525 系统支持可选的内部双 SD 模块 (IDSDM)。

IDSDM 支持两个 SD 卡并通过以下配置提供：

表. 12: 支持的 SD 卡存储容量

IDSDM 卡
<ul style="list-style-type: none">• 16 GB• 32 GB• 64 GB

 **注：**系统还提供一个专用的冗余 IDSDM 卡插槽。

 **注：**使用与 IDSDM 配置的系统关联的 Dell EMC 品牌 SD 卡。

视频规格

PowerEdge R6525 系统支持集成 Matrox G200 图形控制器和 16 MB 视频帧缓冲区。

表. 13: 支持的正面视频分辨率选项

分辨率	刷新率 (Hz)	颜色深度 (位)
1024 x 768	60	8、16、32
1280 x 800	60	8、16、32
1280 x 1024	60	8、16、32
1360 x 768	60	8、16、32
1440 x 900	60	8、16、32
1600 x 900	60	8、16、32
1600 x 1200	60	8、16、32
1680 x 1050	60	8、16、32
1920 x 1080	60	8、16、32

表. 13: 支持的正面视频分辨率选项 (续)

分辨率	刷新率 (Hz)	颜色深度 (位)
1920 x 1200	60	8、16、32

表. 14: 支持的背面视频分辨率选项

分辨率	刷新率 (Hz)	颜色深度 (位)
1024 x 768	60	8、16、32
1280 x 800	60	8、16、32
1280 x 1024	60	8、16、32
1360 x 768	60	8、16、32
1440 x 900	60	8、16、32
1600 x 900	60	8、16、32
1600 x 1200	60	8、16、32
1680 x 1050	60	8、16、32
1920 x 1080	60	8、16、32
1920 x 1200	60	8、16、32

环境规格

i 注: 有关环境认证的其他信息, 请参阅手册和说明文件中的产品环境数据表, 网址: www.dell.com/support/home。

表. 15: 工作气候范围类别 A2

温度	规格
可允许连续工作	
海拔高度 <= 900 米 (<= 2,953 英尺) 的温度范围	在设备无直接光照的情况下, 10 °C 至 35 °C (50 °F 至 95 °F)
湿度百分比范围 (所有时间均非冷凝)	8% RH 和 -12°C 最低露点到 80% RH 和 21°C (69.8°F) 最大露点
工作海拔高度降幅	最高温度超过 900 米 (2953 英尺) 以上时按 1°C/300 米 (1.8°F/984 英尺) 降低

表. 16: 工作气候范围类别 A3

温度	规格
可允许连续工作	
海拔高度 <= 900 米 (<= 2,953 英尺) 的温度范围	在设备无直接光照的情况下, 5–40°C (41–104°F)
湿度百分比范围 (所有时间均非冷凝)	8% RH 和 -12°C 最低露点到 85% RH 和 24°C (75.2°F) 最大露点
工作海拔高度降幅	最高温度超过 900 米 (2953 英尺) 以上时按 1°C/175 米 (1.8°F/574 英尺) 降低

表. 17: 工作气候范围类别 A4

温度	规格
可允许连续工作	
海拔高度 <= 900 米 (<= 2,953 英尺) 的温度范围	在设备无直接光照的情况下, 5–45°C (41–113°F)
湿度百分比范围 (所有时间均非冷凝)	8% RH 和 -12°C 最低露点到 90% RH 和 24°C (75.2°F) 最大露点

表. 17: 工作气候范围类别 A4 (续)

温度	规格
工作海拔高度降幅	最高温度超过 900 米 (2953 英尺) 以上时按 1°C/125 米 (1.8°F/410 英尺) 降低

表. 18: 所有类别的共享要求

温度	规格
可允许连续工作	
最大温度梯度 (适用于操作时和非操作时)	20°C (一小时) * (36°F [一小时]) 和 5°C (15 分钟) (9°F [15 分钟])、5°C (一小时) * (9°F [一小时]) - 针对磁带硬件 <i>注:</i> * — 根据适用于磁带硬件的 ASHRAE 的散热原则, 这些不是温度变化的瞬时速率。
非操作温度限制	-40 至 65°C (-40 至 149°F)
非操作湿度限制	最大露点为 27°C (80.6°F) 时, 相对湿度为 5% 至 95%
最大非工作海拔高度	12,000 米 (39,370 英尺)
最大工作海拔高度	3,048 米 (10,000 英尺)

表. 19: 最大振动规格

最大振动	规格
使用时	5 Hz 至 500 Hz 时, 0.21 G _{rms} (所有操作方向)
存储	10 Hz 至 500 Hz 时, 1.88 G _{rms} , 可持续 15 分钟 (被测的所有六面)

表. 20: 最大撞击脉冲规格

最大撞击脉冲	规格
使用时	在 x、y 和 z 轴正负方向上可承受 6 G 连续执行的撞击脉冲, 最长可持续 11 毫秒。
存储	x、y 和 z 轴正负方向上可承受连续六个 71 G 的撞击脉冲 (系统每一面承受一个脉冲), 最长可持续 2 毫秒。

散热空气限制

ASHRAE A3 环境

- 不支持等于或大于 180 W 的 CPU TDP。
- 不支持背面驱动器。
- 不支持 128 GB 或更高容量的 LRDIMM。
- 在冗余模式下需要两个 PSU, 但不支持 PSU 故障。
- 不支持非戴尔认证的外围设备卡和/或超过 25 W 的外围设备卡。
- 不支持 GPU。
- 不支持 BOSS 1.5。
- 不支持 NVMe。

ASHRAE A4 环境

- 不支持等于或大于 155 W 的 CPU TDP。
- 不支持背面驱动器。
- 不支持 128 GB 或更高容量的 LRDIMM。
- 在冗余模式下需要两个 PSU, 但不支持 PSU 故障。

- 不支持非戴尔认证的外围设备卡和/或超过 Tier 5 卡的外围设备卡。
- 不支持 GPU。
- 不支持 BOSS 1.5。
- 不支持超过 Tier4 的 OCP 3.0 卡冷却层。
- 不支持 NVMe。

液体冷却：ASHRAE A3 环境

- 不支持 128 GB 或更高容量的 LRDIMM。
- 在冗余模式下需要两个 PSU，但不支持 PSU 故障。
- 不支持非戴尔认证的外围设备卡和/或超过 25 W 的外围设备卡。
- 不支持 GPU。
- 不支持 BOSS 1.5。
- 不支持 NVMe。

液体冷却：ASHRAE A4 环境

- 不支持背面驱动器。
- 不支持 128 GB 或更高容量的 LRDIMM。
- 在冗余模式下需要两个 PSU，但不支持 PSU 故障。
- 不支持非戴尔认证的外围设备卡和/或超过 Tier 5 的外围设备卡。
- 不支持超过 Tier4 的 OCP 3.0 卡冷却层。
- 不支持 GPU。
- 不支持 BOSS 1.5。
- 不支持 NVMe。

散热限制值表

表. 21: 散热限制值表

配置		4 x 3.5 英寸			8 x 2.5 英寸		10 x 2.5 英寸 SAS			10 x 2.5 英寸 NVMe	
背面配置		3 LP/ 2 FH	背面 2 x 2.5 英寸 SAS	背面 2 x 2.5 英寸 NVMe	3 LP/ 2 FH	背面 2 x 2.5 英寸 NVMe (单处理器)	3 LP/ 2 FH	背面 2 x 2.5 英寸 SAS	背面 2 x 2.5 英寸 NVMe	3 LP/ 2 FH	背面 2 x 2.5 英寸 NVMe
CPU TDP	CPU cTDP (最大值)										
120 W	150 W	STD 风扇 STD HSK	HPR 风扇 STD HSK	HPR 风扇 STD HSK	STD 风扇 STD HSK	HPR 风扇 STD HSK	VHP 风扇 STD HSK	VHP 风扇 STD HSK	VHP 风扇 STD HSK	VHP 风扇 STD HSK	VHP 风扇 STD HSK
155 W	180 W	STD 风扇 STD HSK	HPR 风扇 STD HSK	HPR 风扇 STD HSK	STD 风扇 STD HSK	HPR 风扇 STD HSK	VHP 风扇 STD HSK	VHP 风扇 STD HSK	VHP 风扇 STD HSK	VHP 风扇 STD HSK	VHP 风扇 STD HSK
180 W	200 W	HPR 风扇 L 型 HSK	HPR 风扇 L 型 HSK	HPR 风扇 L 型 HSK	HPR 风扇 L 型 HSK	HPR 风扇 L 型 HSK	VHP 风扇 L 型 HSK	VHP 风扇 L 型 HSK	VHP 风扇 L 型 HSK	VHP 风扇 L 型 HSK	VHP 风扇 L 型 HSK

表. 21: 散热限制值表 (续)

配置		4 x 3.5 英寸			8 x 2.5 英寸		10 x 2.5 英寸 SAS			10 x 2.5 英寸 NVMe	
背面配置		3 LP/ 2 FH	背面 2 x 2.5 英寸 SAS	背面 2 x 2.5 英寸 NVMe	3 LP/ 2 FH	背面 2 x 2.5 英寸 NVMe (单处理器)	3 LP/ 2 FH	背面 2 x 2.5 英寸 SAS	背面 2 x 2.5 英寸 NVMe	3 LP/ 2 FH	背面 2 x 2.5 英寸 NVMe
CPU TDP	CPU cTDP (最大值)										
200 W	200 W	HPR 风扇 L 型 HSK	VHP 风扇 L 型 HSK	VHP 风扇 L 型 HSK	VHP 风扇 L 型 HSK	VHP 风扇 L 型 HSK	VHP 风扇 L 型 HSK				
225 W	240 W	HPR 风扇 L 型 HSK	VHP 风扇 L 型 HSK	VHP 风扇 L 型 HSK	VHP 风扇 L 型 HSK	VHP 风扇 L 型 HSK	VHP 风扇 L 型 HSK				
280 W - 64C (7H12、7763)		HPR 风扇* L 型 HSK	HPR 风扇* L 型 HSK	HPR 风扇* L 型 HSK	HPR 风扇 L 型 HSK	HPR 风扇* L 型 HSK	VHP 风扇* L 型 HSK	VHP 风扇* L 型 HSK	VHP 风扇* L 型 HSK	VHP 风扇 L 型 HSK	VHP 风扇* L 型 HSK
280 W - 32C (75F3)		-	-	-	VHP 风扇* L 型 HSK	-	VHP 风扇* L 型 HSK	-	-	VHP 风扇* L 型 HSK	-
280 W - 64C/32C/24C 280 W (7773X、 7573X、7473X)		-	-	-	-	-	VHP 风扇 L 型 HSK	VHP 风扇* L 型 HSK	VHP 风扇* L 型 HSK	-	-
280 W - 16C 280 W (7373X)		-	-	-	-	-	VHP 风扇** L 型 HSK	-	-	-	-
T4 或 A2 GPU		HPR 风扇* L 型 HSK	-	VHP 风扇* L 型 HSK	VHP 风扇* L 型 HSK	VHP 风扇* L 型 HSK	VHP 风扇* L 型 HSK	VHP 风扇* L 型 HSK			

注: * 支持的环境温度为 30°C。

注: ** 支持的环境温度为 25°C。

表. 22: 液体冷却散热限制值表

配置		4 x 3.5 英寸			8 x 2.5 英寸	10 x 2.5 英寸 SAS			10 x 2.5 英寸 NVMe	
背面存储		3 LP/2 FH	背面 2 x 2.5 英寸 SAS	背面 2 x 2.5 英寸 NVMe	3 LP/2 FH	3 LP/2 FH	背面 2 x 2.5 英寸 SAS	背面 2 x 2.5 英寸 NVMe	3 LP/2 FH	背面 2 x 2.5 英寸 NVMe
CPU TDP	CPU cTDP (最大值)									
120 W	150 W	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇
155 W	180 W	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇
180 W	200 W	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇
200 W	200 W	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇
225 W	240 W	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇
280 W	280 W	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇
T4 GPU		HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇	HPR 风扇

注: 单处理器需要三个双风扇模块, 双处理器系统需要四个双风扇模块。

注: 对于 T4 GPU 和 280 W CPU, 支持的最高环境温度为 30 °C。对于其他配置, 支持的最高环境温度为 35 °C。

表. 23: 处理器和散热器值表

散热器	处理器 TDP
STD HSK	< 180 W
L 型 HSK	处理器 1 >= 180 W
L 型 HSK	处理器 2 >= 180 W

表. 24: 处理器支持矩阵

处理器	TDP (W)	最大 cTDP (W)	核心	散热器 (HSK) 类型	风扇类型 (x4/x8)	风扇类型 (x10)	支持 A3	支持 A4
7773X	280	280	64	L 型 HSK	不适用	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7573X	280	280	32	L 型 HSK	不适用	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7H12	280	280	64	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7F72	240	240	24	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7F52	225	240	16	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7662	225	240	64	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7643	240	240	56	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7742	225	240	64	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7713P	225	240	64	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否

表. 24: 处理器支持矩阵 (续)

处理器	TDP (W)	最大 cTDP (W)	核心	散热器 (HSK) 类型	风扇类型 (x4/x8)	风扇类型 (x10)	支持 A3	支持 A4
7642	225	240	48	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7552	200	200	48	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7702	200	200	64	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7663	240	240	56	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7543P	225	240	32	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7542	225	240	32	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7532	200	200	32	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7F32	180	180	8	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7513	200	200	32	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7502	180	200	32	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
74F3	240	240	24/48	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7402	180	200	24	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7452	155	180	32	STD HSK	STD 风扇	HPR (金牌级) 风扇	是	否
7443P	200	200	24	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7443	200	200	24	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7352	155	180	24	STD HSK	STD 风扇	HPR (金牌级) 风扇	是	否
7343	200	200	32	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7313P	155	180	16	STD HSK	STD 风扇	HPR (金牌级) 风扇	是	否
7302	155	180	16	STD HSK	STD 风扇	HPR (金牌级) 风扇	是	否
72F3	180	200	8	L 型 HSK	HPR (银牌级) 风扇	HPR (金牌级) 风扇	否	否
7282	120	150	16	STD HSK	STD 风扇	HPR (金牌级) 风扇	是	是
7272	120	150	12	STD HSK	STD 风扇	HPR (金牌级) 风扇	是	是
7252	120	150	8	STD HSK	STD 风扇	HPR (金牌级) 风扇	是	是

表. 24: 处理器支持矩阵 (续)

处理器	TDP (W)	最大 cTDP (W)	核心	散热器 (HSK) 类型	风扇类型 (x4/x8)	风扇类型 (x10)	支持 A3	支持 A4
7262	155	180	8	STD HSK	STD 风扇	HPR (金牌级) 风扇	是	否

注: 如果安装了 280 W CPU, 则需要在空插槽中安装 DIMM 挡片。

注: 处理器 7573X 和 7773X 仅支持 x10 SAS/SATA 驱动器。

表. 25: T4 GPU 支持限制

背面配置	2.5 英寸 x 10		2.5 英寸 x 8		3.5 英寸 x 4	
	3 x LP	2 x FH	3 x LP	2 x FH	3 x LP	2 x FH
插槽 1	支持	支持	支持	支持	支持	支持
插槽 2	支持	支持	支持	支持	支持	支持
插槽 3	支持	不适用	不支持	不适用	不支持	不适用

注: 280 W T4/A2 配置不支持 128 GB LRDIMM 3200 MT/s 或更高内存。

表. 26: 标签参考

标签	说明
STD	标准
HPR	高性能 (银牌级)
VHP	极高性能 (金牌级)
HSK	散热器
LP	薄型
FH	全高